PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

59-160140

(43)Date of publication of application: 10.09.1984

(51)Int.CI.

GO3C 1/71 **C08F** 2/46 CO8G 73/10

G03F 7/08

(21)Application number: 58-034907

(71)Applicant:

TORAY IND INC

(22)Date of filing:

03.03.1983

(72)Inventor:

OBAYASHI GENTARO

UMEMOTO SUSUMU HIRAMOTO YOSHI

(54) POLYMER COMPOSITION SENSITIVE TO CHEMICAL RAY

(57) Abstract:

PURPOSE: To improve the sensitivity to chemical rays by blending a polymer consisting essentially of specified structural units with a compound polymerizable under chemical rays and a specified amino compound.

CONSTITUTION: The titled composition is formed by blending a polymer consisting essentially of structural units represented by the formula with a compound dimerizable or polymerizable under chemical rays and having an unsatd, bond and an amino group or its quaternized salt and an aromatic secondary or tertiary amino compound having saponifiable >C=O not bonding directly to the aromatic ring having a bonded secondary or tertiary amino group. In the formula, R1 is a ter- or quater-valent org. group having plural carbon atoms, the preferred group has a structure in which as atom in the aromatic or aromatic heterocyclic ring bonds directly to each carbonyl group in the principal chain of the polymer in respect of the heat resistance of the polyimide polymer, R2 is a bivalent org. group having plural carbon atoms, the preferred group has a structure in which an atom in the aromatic or aromatic heterocyclic ring bonds directly to each amido group in the principal chain of the polymer, R3 is H, an alkali metallic ion or an ammonium ion.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

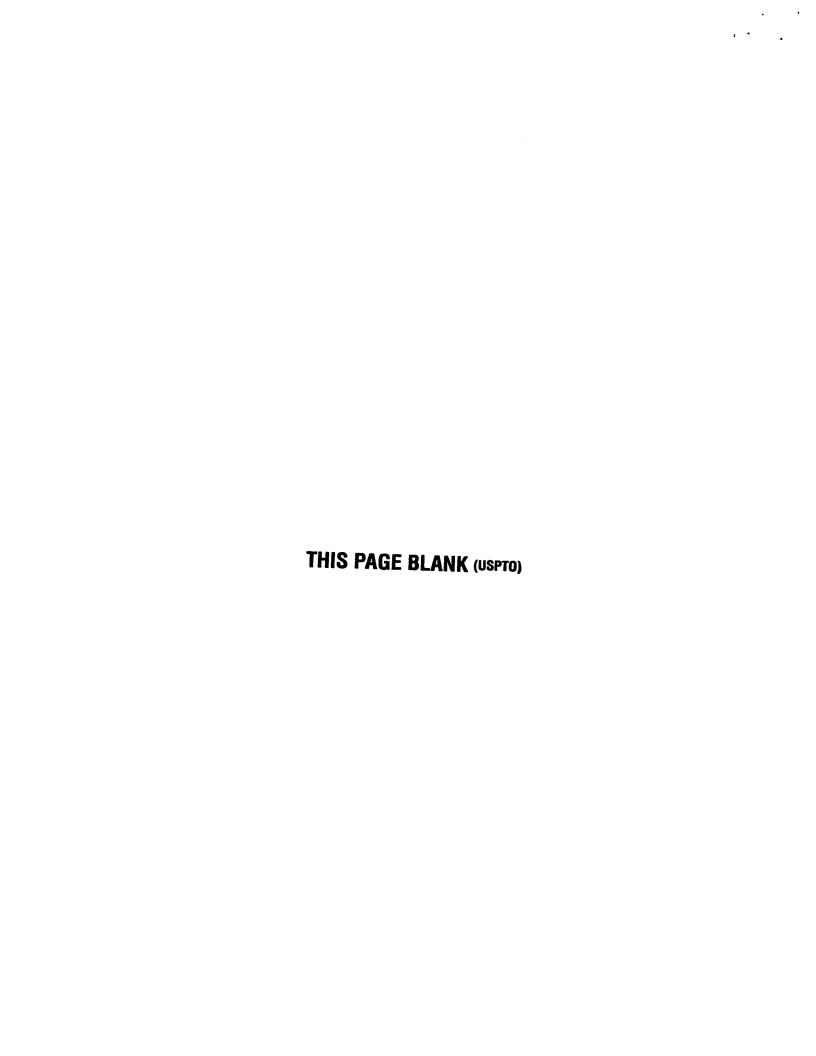
[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]



(19) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭359—160140

௵Int. Cl.³				
G 03 C	1/71			
C 08 F	2/46			
C 08 G	73/10			

G 03 F

識別記号

104

庁内整理番号

③公開 昭和59年(1984)9月10日

7267-2H 7102-4 J 7342-4 J

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 11 頁)

9化学線感応性重合体組成物

7/08

创特

願 昭58-34907

20出

昭58(1983) 3月3日

70発明

者 大林元太郎 大津市園山1丁目1番1号東レ

株式会社滋賀事業場内

者 梅本晋 70発明

大津市園山1丁目1番1号東レ 株式会社滋賀事業場内

仰発 明 者 平本叔

大津市関山1丁目1番1号東レ 株式会社滋賀事業場内

人 東レ株式会社 勿出 願

> 東京都中央区日本橋室町2丁目 2番地

発明の名称

特許請求の範囲

(a) 一般式 (1)

> ← CO-R'-CONH-R'-NH → (COOR')n

て扱わされる構造単位(「」を主成分とする ポリマ(但し、式中 R'は少なくとも2個以 上の炭素原子を有する3価または4価の有機 基。 R*は少なくとも2個以上の炭素原子を有 する2価の有機基、Rは水素。アルカリ金属 イオン又はアンモニウムイオンを表わす。 nは1又は2である)と。

- (b) 化学線により2量化又は重合可能な不 飽和結合及びアミノ基又はその4級化塩を含 む化合物(耳)と,
- (c) 第2級アミノ基又は第3級アミノ基が 結合している芳香核に直接 C = D が結合し ていない芳香族第2級又は第3級アミノ化合 物(皿)

とからなる化学線感応性重合体組成物。

(a) 一般实

← CO-R'-CONH-R*-NH → (COOR'),

で表わされる構造単位〔Ⅰ〕を主成分とする ポリマ(但し。式中 R'は少なくとも2個以 上の炭素原子を有する3個または4価の有機 基。R*は少なくとも2個以上の炭素原子を有 する 2 価の有機基,R'は水素,アルカリ金属 イォン又はアンモニウムイオンを表わす。 n 出1又は2である)と。

- (b) 化学線により2量化又は重合可能な不 飽和結合及びアミノ基又はその4級化塩を含 む化学物(耳)と,
- (c) 第2級アミノ基又は第3級アミノ基が 結合している芳香核に直接Y >C = 0 が結合し ていない芳香族第2級又は第3級アミノ化合 物(目)と、
- (d) 芳香族アジド化合物 [パ] とからなる化学線感応性重合体組成物。

特開昭59-160140(2)

3. 発明の詳細な説明

「産業上の利用分野」

本発明は耐熱性ポリマの前駆体であつて、化学 線感応性に優れた重合体組成物に関するものであ る。

〔従来技術〕

化学線、特に光感応性を付与したポリイミド前駆体組成物としては、半導体の絶縁層やパッシペーション層用に開発された次のものが知られている。

(a) ポリアミド酸と 1 ~ 5 重量 8 の 重 クロム酸塩とからなる組成物 (例えば U S P 4 3 6 2 3 8 7 0)

で例示されるような構造のエステル基で感光性基を導入したポリイミド前駆体組成物(例えばUSP 3.957,512, UBP4,040,831)。

つた。

(b)においては、ポリマは主として、感光性基と2酸塩化物基を有する化合物とジアミンとを反応させることによつて重合しており、その製造工程が複雑であるばかりでなく、脱塩酸によつて生じる塩素イオンが膜中に残るために半導体用途では信頼性に悪影響を及ぼす可能性があつた。

(c) に 配した 材料 は これらの 欠点 を 改良した 材料 で あるが , これらに おいて もその 感度 がい ずれも 数 百 m J / m * 程度 と 低 く , 半 導 体 工 業 で 通 常 用 い られ て い る 露 光 装 置 で 処理 する に は 不 充 分 で ある。 [発 明 の 目 的]

本発明は、上記従来技術の欠点を解消せしめ、耐熱性ポリマの前駆体において、化学廠に感応性の優れた重合体組成物を提供せんとするものである。

(発明の構成)

本発明は上記目的を達成するため次の棚成。すなわち、

(1) (a) 一般式

(c) ポリアミド酸に化学線により2畳化又は重合可能な炭素一炭素二重結合およびアミノ遊叉はその四級化塩を含む化合物を添加した組成物(例えば特開昭54-145794)。

これらはいずれも適当な有機溶剤に溶解したワニス状態で基板に塗布, 乾燥して塗膜とした後に, 適当なフォトマスクを介して紫外線照射した後に現像し、リンス処理して所望のレリーフ・パターンを得ている。

パターン化したポリイミド前駆体の被腹はさら に適当な加熱処理を行なうことにより耐熱性を有 するポリイミド被膜としている。

しかし、かかる従来の組成物は光で直接パターン化し得るが次の欠点を有している。すなわち、(a)においては組成物の安定性が著しく悪く、ポリアミド酸と重クロム酸の混合後ただちに使用する必要があり、工業的な利用には大きな側約となるという欠点がある。またパターン化した膜中に無機イオンが存在するために、無機イオンの存在が信頼性に悪影響を及ぼす半導体用途には不適であ

で表わされる構造単位 [i] を主成分とするポリマ (但し、式中 R'は少なくとも 2 個以上の炭素原子を有する 3 価または 4 価の有機基、 R'は少なくとも 2 個以上の炭素原子を有する 2 価の有機基、 R'は水素、 アルカリ金属イオン又はアンモニウムイオンを表わす。 ロは 1 又は 2 である)と、

- (b) 化学線により2量化又は重合可能な不 飽和結合及びアミノ基又はその4級化塩を含 む化合物(II)と、
- (c) 第2級アミノ基又は第3級アミノ基が (c) 第2級アミノ基又は第3級アミノ基が 結合している芳香核に直接 C = 0 が結合していない芳香族第2級又は第3級アミノ化合物(II)

とからなる化学線感応性重合体組成物ならびに上記(1)項の組成物に芳香族アジド化合物 [N] を混合してなる化学線感応性重合体組成物を特徴とするものである。

特開昭59-160140(3)

本発明における構造単位 (1) を有するポリマ (以後, ポリイミド系ポリマ前駆体と呼ぶ)とは, 前記一般式で示される構造を有し, 加熱あるいは適当を触媒によりイミド環や, その他の環状構造を有するポリマ (以後, ポリイミド系ポリマと呼ぶ)となり得るものである。

上記構造単位(1)中、R'は少なくとも2個以上の炭素原子を有する3価または4価の有機基である。ボルイミド系ボリマの耐熱性の面から、R'はポリマ主鎖のカルボニル基との結合が芳香族環あるいは芳香族複素環から直接行なわれる構造を有するものが好ましい。従つてR'としては、芳香族環又は芳香族複素環を含有し、かつ炭素数6~30の3価又は4価の基が好ましい。

R'のより好ましい具体的な例としては,

上記構造単位 (1) 中, R*は少なくとも2個以上の炭素原子を有する2 価の有機基であるが, ポリイミト系ポリマとした時の耐熱性の面から, ポリマ主鎖のアミト基との結合が芳香族環あるいは芳香族複素環から直接行なわれる構造を有するものが好ましい。従つて R*としては芳香族環又は芳香族複素環を含有し,かつ炭素数6~30の2 価の基が好ましい。

R®の好ましい具体的な例としては,

(式中、結合手はポリマ主鎖のカルボニル基との結合を表わし、カルボキシル基は結合手に対してオルト位に位置するが、この結合手は上記構造式には記載していない)。

などが挙げられるが、これらに限定されない。

また構造単位 (I) を有するポリマは、 R'がこれ ちのうちただ 1 種から構成されていてもよいし、 2 種以上から構成される共重合体であつてもよい。 R'として特に翌ましいものは、

である。(但し式中, 結合手の定義については前述と同様である)。

(式中,結合手は主鎖のアミト基との結合を表わす)などが挙げられる。また、これらがポリイミド系ポリマの耐熱性に悪影響を与えない範囲内でアミノ基、アミド基、カルボキシル基、スルホンアミド基などの核置換差を有していても差支えない。/特に好ましい例として

が挙げられる。

構造単位 [1] を有するポリマは、Rがこれらの うちただ 1 種から構成されていてもよいし、2 種 以上から構成される共重合体であつてもよい。

特期四59-160140(4)

まがりま さられ、ポリイミドの接着性を向上させるため に、耐熱性を低下させない範囲で Rick して、シロ キサン構造を有する脂肪族性の基を共重合するこ

とも可能である。好ましい具体例として

などが挙げられる。

構造単位 [1] を主成分とするポリマの具体的な例として。

ピロメリツル酸二無水物と 4. 4-ジアミノジァ エニルエーテル,

ピロメリット酸二無水物および 3, 3′, 4, 4′ーベンソフエノンテトラカルボン酸と 4, 4′ージアミノジフエニルエーテル

3. 34, 4.4'ーベンソフェノンテトラカルボン酸 二無水物と 4.4'ージアミノジフェニルエーテル。

3. 3′. 4. 4′-ビフエニルテトラカルポン酸二無水物と 4. 4′- ジアミノジフエニルエーテル,

3. 3′. 4. 4′ ーピフエニルテトラカルポン酸二無

水物および 3. 3', 4. 4' ーベングフェノンテトラカルボン酸二無水物と 4. 4'ージアミノジフェニルエーテル

ピロメリット酸二無水物と 3.3% - ジアミノシフエニルスルホン。

ピロメリット酸二無水物および 3.31.4.41 ーベンソフエノンテトラカルボン酸二無水物と 3.31ー(又は 4.41ー) シアミノシフエニルスルホン,

3. 3', 4, 4' ーペングフェノンテトラカルボン酸 二無水物と3. 3'-(又は 4, 4'-) ジアミノジフェニ ルスルホン.

3. 3′, 4. 4′ ーピフエニルテトラカルポン酸二無水物と 3. 3′ー(又は 4. 4′ー)ジアミノジフエニルスルホン。

3. 3′, 4. 4′ ーピフエニルテトラカルポン酸二無 水物 および 3. 3′, 4. 4′ ーペンソフェノンテトラカ ルポン酸 無水物 と 3. 3′ー(又は 4. 4′ー)ジアミノ ジフェニルスルホン、

ピロメリント酸二無水物と4.4′ーシアミノシフ エニルエーテルおよびピス(3ーアミノプロピル)

テトラメチルジシロキサン,

ピロメリット酸二無水物および 3. 3', 4. 4' ーベンゾフエノンテトラカルボン酸二無水物と 4. 4'ージアミノジフエニルエーテルおよびピス(3ーアミノプロピル)テトラメチルジシロキサン。

3. 31, 4. 4' ーベンソフェノンテトラカルボン酸 二無水物と 4. 4'-ジアミノジフェニ ルエーテルお よびピス(3ーアミノプロピル)テトラメチルジ シロキサン。

3. 3', 4. 4' ーピフエニルテトラカルボン酸二無水物と 4. 4'ージアミノ-ジフエニルエーテルおよびピス(3ーアミノプロピル)テトラメチルジシロキサン,

3. 3. 4. 4' ーピフエニルテトラカルボン酸二無 水物および 3. 3', 4. 4' ーペンソフエノンテトラカ ルボン酸無水物と 4. 4'ージアミノジフエニルエー テルおよびピス (3 ーアミノプロピル) テトラメ チルジシロキサン。

ピロメリット酸二無水物と 3. 3/- (又は 4.4'-) ジアミノジフエニルスルホンおよびピス (3 - ア ミノブロピル)テトラメチルジシロキサン。

ピロメリット酸二無水物および 3. 3, 4, 4 ーベングフェノンテトラカルボン酸二無水物 と 3. 3 ー (又は 4, 4'ー) ジアミノジフエニルスルホンおよびピス (3 ー アミノプロピル)テトラメチルジシロキサン,

3. 3. 4. 4'ーベンソフエノンテトラカルボン酸二 無水物と 3. 3'ー(又は 4. 4'ー)ジアミノジフエニ ルスルホンおよびピス(3 ーアミノプロピル)テトラメチルジシロキサン。

3. 3. 4. 4' ーピフェニルテトラカルボン酸二無水物と3. 3'ー(又は4. 4'ー)ジアミノジフェニルスルホンおよびピス(3ーアミノプロピルテトラメチルジシロキサン。

3. 3', 4, 4' ーピフエニルテトラカルボン酸二無水物および 3. 3', 4, 4' ーペンソフェツンテトラカルボン酸二無水物と 3. 3'ー(又は 4. 4'ー)ジアミノジフエニルスルホンおよびピス(3 ーアミノア'ロビル)テトラメチルジシロキサン

などから合成されたポリアミド酸が好ましく用い

られる。

構造単位 (1) を主成分とするポリマとは、構造単位 (1) のみから成るものであつてもよい。共産の構造単位との共産合体であつてもよい。共産の関係の関係の対象を加熱処理によつて得られるポリイミド系ポリマの耐熱性を著しく摂わない範囲で選択するのが望ましい。ポリアミド酸、ポリエステルアミド酸の構造単位が典型的な例として挙げられるが、これらには限定されない。

化学線により2量化又は重合可能な不飽和結合及びアミノ基又はその4級化塩を含む化合物(II)とは、1分子中に炭紫一炭紫二重結合とアミノ基又は4級化したアミノ基を含む化合物である。

下記の一般式 [A]

$$C_{H} = C R'$$

$$COOR'N$$

$$R'$$

(ここでR'は水素又はフェニル勘。 R'は水素又

$$C_H = C_{H_*}$$
, $C_H = C_{H_*}$

は炭素数1~6の低級アルキル基、R'は置換又は無置換の炭素数2~12の炭化水素基、R',R' は置換又は無置換の炭素数1~6のアルキル基を各々表わす)と、

一般式[B]

$$R \cdot \bigcirc CH = CH,$$
 (B)

(ととで R'は無 置換又は置換の 炭素数 1 ~ 6 の アルキル基を表わす) と。

一般式[C]

$$(CH, = C - CH \rightarrow N - H^{C})$$
(C)

(とこで、 R^{10} は水衆又はメチル基を扱わし、 $n+\ell=3$ 、 $n=1\sim3$ である)。 ちるいはこれらの四級化塩などが好ましく用いられる。

好ましい具体的な例として、

$$CH_{*} = CH - CH_{*}NH_{*}$$
 .
 $CH_{*} = C - CH_{*}NH_{*}$.

アミノ基が四級化されていない化合物の場合は 構造単位 [1] の R が水紫のものと組合せるのが望ましい。アミノ基が四級化されている化合物の場合は構造単位 [1] の R がアルカリ金属イオン又は アンモニウム・イオンのものと組合せるのが望ま しい。この場合、容液中にアルカリ金属の塩化 のような無機化合物が析出することがあるが、沪 過などでとり除いておくのが望ましい。

化合物(II)は構造単位(II)を主成分とするポリ

特開昭59-160140(6)

マの全カルボキシル港(又はその塩)の0.05当 量以上、好ましくは0.3当量以上で、かつ2倍当 量以下でポリマと混合されているのが望ましい。 との範囲をはずれると感光性が悪くなつたり、現 像時間、温度などの現像条件の許容巾が狭くなつ たりするおそれがあるので注意を要する。

い)を呈していてもよく,極性の假拠悲を有して いてもよい。そして通常炭素数1~12,好まし くは1~6のものが用いられる。

アミノ化合物 (II) の好ましい具体的な例としては、Nーフェニルエチルアミン、Nーフェニルー Nーエチルでジャアミン、Nーフェニルー Nーエチル・リン、Nーフェニルー Nーフェニルー Nーフェニルー Nーフェニルー Nーフェニルー Nーフェニル タノールアミン、Nーフェニル シェタノールアミン、Nーフェニル) ジェタノールアミン、Nー(3ーメチルフェニル) ジェタノールアミン、Nー(4ーメチルフェニル) ジェタノールアミン、Nー(4ーメチルフェニル) ジェタノールアミンが げっれる。

上記アルキル遊が結合したアミノ茲を有する芳香族第2級または第3級のアミノ化合物のうちでアルキル基に極性の置換基を有するものがより好ましく、とくに概性の置換基として水酸基を有す

第2級又は第3級アミノ基の結合した芳香核に 小はり 直接結合した C = O 基を有する場合には、例え

のアミノ化合物である。

は特開昭 5 4 - 1 4 5 7 9 4 号公報に示される如く目的とする十分な感度の向上が達成しがたい。

るアミノ化合物すなわち、アミノ基の少なくとも 1個の水素を水酸基を有するアルキル基で置換し た芳香族アミノ化合物が最も好ましい。

化合物 (II) は構造単位 (I) を主成分とすでポリマの重置に対し0.1 重量を以上混合するのが望ましく、より好ましくはポリマの重量に対し0.5 重量を以上で、かつ20重量を以下の割合で混合するのがよい。この範囲をはずれると感光性が悪くなつたり、現像時間、温度などの現像条件の許容巾が狭くなつたりするおそれがあるので注意を要する。

本発明の組成物の一製造法について説明する。まず溶媒中でジアミン化合物と酸二無水物を反応させ、構造単位[I]を主成分とするボリマを得、次にこの溶液に化合物 [I] および [I] . 必要に応じて他の添加剤を溶解調合することにより製造することができる。なお、上記のポリマとして密液から分離精製したポリマを再溶解して用いても差支えない。

特開昭59~160140 (ア)

上記製造方法で用いる溶媒としてはポリマの溶解性の面から復性溶媒が好ましく用いられ、特に非プロトン性極性溶媒が好適である。非プロトン性極性溶媒が好適である。非プロリドン・N、Nージメチルホルムアミド、N、Nージメチルスルホオキンド、メチルアセトアミド、ジメチルスルホオキンド、ヘキサメチルホスホロトリアミド、セーブチロラクトンなどが好ましく用いられる。

他の添加剤としては、増感剤、共宜合モノマあるいは基板との接着改良剤を感度と耐熱性が大幅 に低下しない範囲で含んでいてもよい。

なか、化合物(II) の混合量が 0.5~1 0 重量が 0.4合には、増感剤としてミヒラ・ケトン、4.4 ーピス(ジェチルアミノ) ベンゾフエノンなどが 好ましく用いられる。増感剤を加えることにより、 本発明の組成物の化学競感応性をさらに向上させることができる。

共重合モノマとしてモノマレイミド、ポリマレイミトあるいはそれらの置換体が好ましく用いられるが、これらには限定されない。

て炭素数としては通常6~30,好ましくは6~21のものである。アジド基は分子中に1個であってもよく(以後,芳香核モノアジド化合物と称する),アジド基が結合した芳香核がさらに上記したような2価の基によつて結合し分子中に2個のアジド基があつてもよい(以後,芳香族ビスアジド化合物と称する)。

具体的には.

などの芳香族モノアジド化合物、および

なか、本発明は上記のどとき化学線感応性重合体組成物を特徴とするものであるが、この組成物に芳香族アジド化合物 (N) を加えることにより、さらに化学線感応性の優れた組成物とすることができる。

この場合の組成物の製造方法としては、上記の化学線感応性組成物を製造する際に、さらに芳香族アジド化合物を追加して溶解調合する方法が1例として挙げられる。

芳香族アジド化合物 (F) とは、アジド基 (N,-) が芳香核に直接結合した化合物であつて、ここでいう芳香核とはベンゼン核、ナフタレン核、アンスラセン核、ナフトキノン核、アンスラキノン核などをさす。これら芳香核は低級のアルキル基、アルコキシ基、カルボキシアルキル基、ニトロ基、ハロゲン基、などで置換されていてもよく、また-0-基、-CH,-基、

$$N \stackrel{CH=CH}{\longrightarrow} CH \stackrel{N}{\longrightarrow} CH \stackrel{N}{\longrightarrow} SO \stackrel{N$$

などの芳香族ピスアジド化合物などが好ましく用 いられるが、これらに限定されない。

アジド化合物の溶解性, 感光波長域の選択の容易さ、製造の容易さの面からとくに芳香族モノアジド化合物が好ましい。

芳香族アジド化合物 (N) は、構造単位 (I) を主成分とするポリマの重量に対し、0.1 重量を以上加えるのが選ましく、より好ましくはポリマの重量に対し0.5 重量を以上で3.0 重量を以下の割合で加えるのがよい。この範囲をはずれると、現像

14111 CO 110140 (O)

性や組成物の保存安定性に悪影響を及ぼすおそれがあるので注意を要する。

次に本発明の組成物の使用方法について説明する。本発明の組成物は化学線を用いた周知の協細加工技術でパターン加工が可能である。

まず本発明の組成物を適当な支持体の上に塗布する。塗布方法としては、スピンナーを用いた回転塗布、スプレーコータを用いた噴霧塗布、浸漬、印刷、ロールコーテイングなどの手段が可能である。塗布膜厚は塗布手段、組成物の固型分濃度、粘度によつて調節することができる。

本発明の組成物を塗布する支持体の材質としては、例えば金属、ガラス、半導体、金属酸化物 絶縁体 (例えば、TiO.、Ta.O.、SiO、など)、窒化ケイ素などが挙げられる。

本発明の組成物の途膜又は加熱処理後のポリイミド被膜と支持体との接着性を向上させるために 適宜接着助剤を用いることもできる。

接着剤として、オキシプロピルトリメトキシシ ラン、よーギリシドキシプロピルトリメトキシシ ...

ーピロリドン、Nーアセチルー2ーピロリドン、N、Nージメチルホルムアミド、N・Nージメチルスルホオキンド、ジメチルスルホオキンド、ジメチルスルホオキンド、ジメチルスルホオキンド、ジェール、インプロピルアルコール、ステルカルピトール、エチルカルピトール、エチルカルピトール、これできる。又アンモニア水やその他のアルカリ水溶液が使用可能な場合も多い。

現像は上記の現像液を塗膜面にスプレイする、 あるいは、現像液中に浸漬する、あるいは浸漬し ながら超音波をかけるなどの方法によつて行なり ことができる。

現像によつて形成したレリーフ・バターンは、ついでリンス液により洗浄することが好ましい。 リンス液には現像液との混和性の良いメタノール、 エタノール、イソプロピルアルコール、酢酸プチ ルなどが好ましく用いられる。

上記の処理によつて得られたレリーフ・パターンのポリマは耐熱性を有するポリイミド系ポリマ

ラン、 **ア**ーアミノプロピルトリエトキシシラン、 **ア**ーメタクリルオキシプロピルトリメトキシシランなどの有機ケイ案化合物あるいは、アルミニウムトリス(エチルアセトアセテート)、アルミニウムトリス(アセチルアセトネート)などのアルミニウムキレート化合物あるどのチタニウムキレート化合物などが好ましく用いられる。

次に上記支持体上で塗膜となつた本発明の組成物に所望のパターン状に化学線を照射する。化学線としては X 線、電子線、紫外線、可視光線などが例として挙げられるが、紫外線かよび短波長の可視光線、すなわち波長範囲で 2 C O n m ~ 5 O O n m が好ましい。

ついで未照射部を現像液で溶解除去することによりレリーフ・パターンをうる。現像液はポリマの構造に合せて適当なものを選択する。

現像液は本組成物の器媒であるNーメチルー2

の前駆体であり、加熱処理によりイミド環やその 他の環状構造を有する耐熱ポリマとなる。

本発明の組成物の化学線感応性の度合(感度)は支持体基板上に形成した被膜に,グレースケール(コダツク社 Photographic Step tablet Na 2 21 STBPS)を介して高圧水銀灯の光を照射し,次に現像し,最少光量で被膜が残つた段数で判定した。上記グレースケールでは段数が1 段増加することに透過光量が前段の 1//2 に減少する。したがつて段数の大きいもの程,感度が高い。

本発明の化学級感応性重合体組成物は、半導体のパッション腹、多層集積回路の層間絶縁腹、プリント回路の異、混成集積回路の層間絶縁腹、プリント回路の半田付保酸膜、液晶用配向膜などの形成に供せられる。さらに高耐熱性のフォトレジストとして金属付着や、ドライ・エッチング・プロセス知の用を可能である。その他ポリイミトの公窓の用途へ適用できる。

(発明の効果)

本発明は上述したように構造単位 (!) を主成分

特開昭59-160140(9)

とするポリマと、化学顔により2昼化又は重合可能な不飽和結合およびアミノ甚又はその4級化を含む化合物(B)と芳香族第2級又は第3級アミノ化合物(B)とから化学顔感応性の起成物を構成したので、その作用機構は現在のところ、まだ解明されていないが、周知の増感剤を用いた組成物に比べて、大幅に感度が向上するという予想外の効果を得ることができたものである。

また、構造単位 (i) を主成分とするポリマと化合物 (II) および化合物 (II) とからなる本発明の組成物に、芳香族アジド化合物、好ましくは芳香族モノアジド化合物を加えれば、感度がさらに向上する他、アジドが化学態感応により、分解するため化学線、とくに紫外線の照射にしたがつて腹の深いところまで化学線がとどき厚腹のパターン形成に有利であるなどの効果がある。

なか、本発明で用節の定義は次の通りである。 耐熱性とは、窒素雰囲気中、2000で1時間 加熱しても形成したレリーフ・バターンのぼけや 熱減量がほとんどないことをいう。

をわち、20mJ/m 第光した。解光後ジメチルア をおり、20mJ/m 第光した。解光後ジメチルア をおり、5mgには、20mJ/m 20mJ/m 2

比較例1

.-------

実施例1 で得たポリマ溶液(A) 4 0 gとミヒラ・ケトンおよび ジェチルアミノエチルメタクリレート 5.6 gを N ーメチルピロリドン 4.5 g に溶解した密液を混合, 炉過した組成物を実施例 2 と同様にしてテストした。ミヒラ・ケトンの量を0.009 g から, 0.9 g まで調節して調べたところ,

次に、実施例に基づいて本発明の実施態様を説明する。

奥施例1

ジアミノジフエニルエーテル 6 8 g を N ーメチルー 2 ーピロリドン 6 0 0 g に 密解し、アミン溶液を調合した。ペンソフエノンテトラカルボン酸二酸無水物 + 6-8 g を加えて分散し、ついで 5 0 で 7 3 時間反応させることにより、30 でで 2 0 ポネズのポリマ溶液(A) を得た。

溶液(A) 4 0 g とジエチルアミノエチルメタクリレート 5.6 g を混合し、ついで N ーフエニルジエタノールアミン 0.6 g を、N ーメチルピロリドン4.5 g 化溶解した溶液を混合、炉過した。

得られた溶液をスピンナーでシリコンウェハ上に回転塗布し、ついで 8 0 ° ° ° ° 1 時間乾燥して 5 μの塗膜を得た。 この塗膜は平坦でむらがなく、かつ基板に十分密着していた。 この塗膜の上に縞模様のマスクを密着させ、 2 0 0 Ψ の高圧水銀灯で 2 秒間紫外線照射した。 露光面での紫外線強度は 3 6 5 n m の波長域で 10 m Ψ/m ° ° であつた。 す

約0.2g 感 が したと ころで 増 感 効果 の 向 上 は 頭 うちと なつ た。 現 像 後 . 被 腹 が 残 存 す る 最 少 鄭 光 段 数 . す な わ ち . 感 度 は 4 段 で あ つ た 。

奥施例2~1 6

実施例2~16は芳香族アミノ化合物および芳香族アジド化合物、増感剤の種類と量を変えて調製した溶液についてグレースケール法で感度を評価した。その結果を装1に示した。

表中・重量すとは、添加した化合物の重量をポ リマの重叠で除して100を掛けた数値である。

密液の調製、感度の試験は下配のようにして行なった。

実施例1で得た溶液(A)にジェチルアミノエチルメタクリレートを混合し、ついで芳香族アミノ化合物をNーメチルピロリドンに溶解した溶液(芳香族アジド化合物。増感剤を添加する場合にはさらにこれらを加えて溶解した溶液)を混合、炉過した。

得られた密液を用いて実施例1と同様にしてシ リコンウェハ上に強膜を形成した。縞文様のマス クの替りにグレースケールを密着させ、同じ水銀灯で1 D 秒間紫外線照射した。現像後被膜が残存する最小露光段数、すなわち、感度を判定した。

表1から明らかなように、実施例2~8により 芳香族第2級および第3級アミノ化合物が、感度 向上効果を有し、かつ、その効果が優れたもので あることが解る。

実施例 9 により、芳香族アミノ化合物を少貴用いる場合に、問知の増感剤の代表例であるミヒラ・ケトンを併用することにより感度向上効果が増幅されることが解る。

実施例10~15により周知の増感剤を用いるかわりに、芳香族アジド化合物を用いることによっても、周知の増感剤併用と同等か。それ以上に感度が向上することが解る。

実施例 1 6 により芳香族アミノ化合物と芳香族アジド化合物を用いた場合に、ミヒラ・ケトンなどの周知の増感剤を併用すれば、さらに感度が向上することが解る。

表 1 (1/2)

No.	芳香族アミノ化合物 (重量を)	芳香族アジド化合物 (重量*)	增 感 剂 (重量系)	感 強度 (段)
2	Nーフエニルジエタノールアミン (1.0)			5
3	间 上 (6.4)			1 0
4	N ーフエニルーNーエチルペンジルアミン (6.4)			7
5	N-7エニルーN-(2-ンアノエチル)エチルアミン (6.4)			5
6	Nーフエニルモルホリン (6.4)			5
7	N-フエニルエタノールアミン (64)			1 0
8	N - (3-メチルフエニル)ジエタノールアミン (6.4)			1 0
9	N - フェニルジェタノールアミン (1.0)		ミヒラ・ケトン (1.6)	9

表 1 (2/2)

Hts.	芳香族アミノ化合物 (重量を)	芳 香族 ア ジ ド 化 合 物 (重 量 乡)	増 感 剤 (重量を)	感 度
10	同 上 (1.0)	м,—Сн — сн — м, (1.6.)		9
11	·同 上 (6.4)	$N_{3}-\bigcirc CH = CH - C -\bigcirc I$ $O.$ (1.0)		10
12	同 上 (3.2)	间 上 (3.2)		9
13	同 (2.0)	间 <u>上</u> (5.0)		10
14	同 <u>上</u> (6.4)	同 上 (3.2)		. 12
15	旬 上 (1.6)	O (3.2)	·	9
16	同 上 (3.2)	N, -CH = CH - C - (3.2) 0	ミヒラ・ケトン	11

61.8.4

特許法第17条の2の規定による補正の掲載

昭和 58 年特許願第 34907 号 (特開 昭 59-160140 号, 昭和 59 年 9月10日 公開特許公報 発行 59-1602 号掲載)につ いては特許法第17条の2の規定による補正があっ たので下記のとおり掲載する。

Int.CI.	識別記号	庁内整理番号
G03C 1/71	Y	7 2 8 7 - 2 H
C 0 8 F 2 / 4 6 C 0 8 G 7 3 / 1 0		7 1 0 2 - 4 J 2 1 0 2 - 4 J
G03F 7/08	104	

昭和 月 В

特許庁長官 思思 明雄

1. 事件の表示

昭和58年特許顯第34907号

手統補正靈

2. 発明の名称

化学線感応性重合体組成物

3. 補正をする者・

事件との関係 特許出願人

住所 東京都中央区日本横室町2丁目2番地 名称 (315) 東レ株式会社

代表取締役社長 伊藤



5. 補正により増加する発明の数 なし

6. 補正の対象 明細書の「発明の詳細な説明」の欄

7. 補正の内容

明細魯中

(1)第8頁1~5行の構造式を次のとおり補正 する。

648号明細書やPolymer Prepri nts Volume 15 Number 1 A pril 1974の775~780頁などに記 載された周知のもの〉」

(2)第16頁中段の一般式(C)を次のとおり 補正する。

$$R^{10}$$

(CH₂ = C-CH₂ + $_{D}N$ - H₂ (C)

(3) 第20頁14行の「また、- CH2-基」 を「また、これら芳香核は一〇円2 - 基」と補正

する。

(4) 第37頁の表1(2/2)の次に行を改め て次の文章を追加する。

「実施例17

実施例11の溶液を用いて、実施例1と同様に してシリコンウエハ上に塗膜を形成した。続いて 435nmの光を用いたステツプアンドリピート 型の露光機でパターンを焼付けた。次に実施例1 と同様にして現像した。〇.5秒露光したところ 残膜収率70%で良好なパターンが得られた。

全く同様のテストを比較例1で使用した溶液を 用いて行なったところ塗膜は全て溶出し、パター ンを得ることができなかった。」